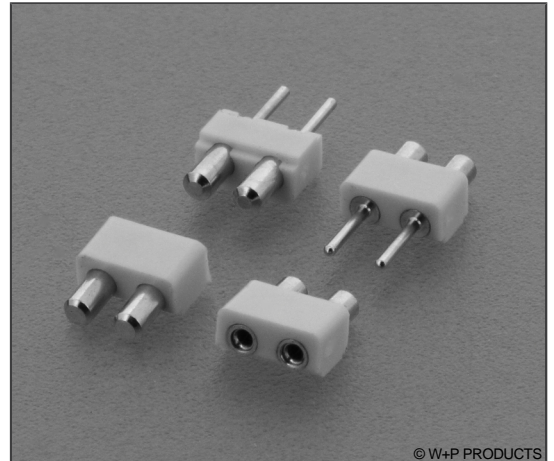


5250

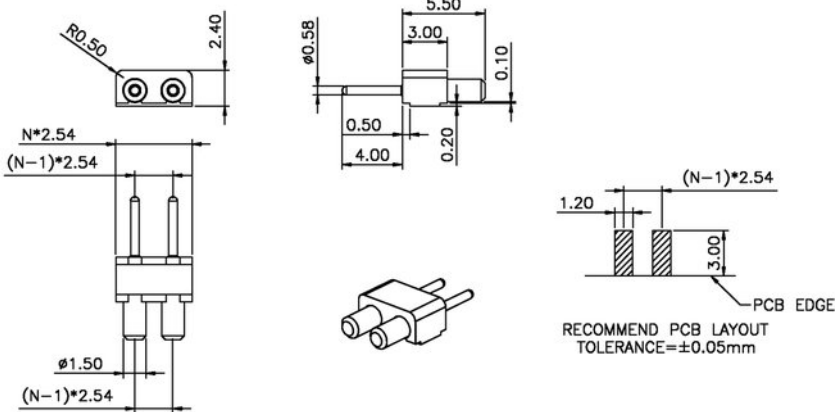
LED Verbinder RM 2,54mm LED Connectors 2.54mm Pitch

Technische Daten / Technical Data

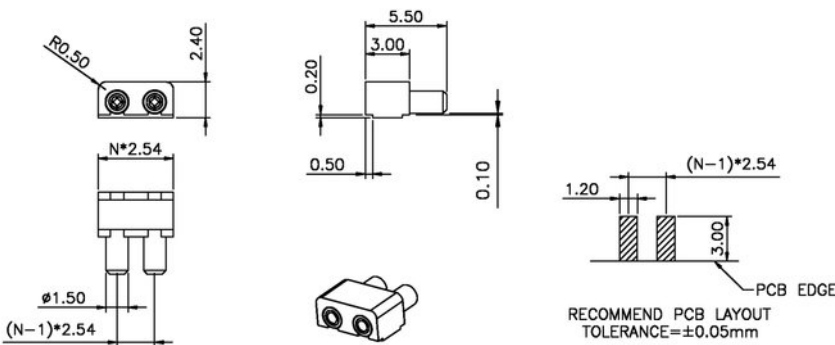
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 HB (UL94 V-0 auf Anfrage) <i>Thermoplastic, rated UL94 HB (UL94 V-0 on request)</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ < 10 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ > 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC 500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A 1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C -55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	260 °C max. für 3-5s 260 °C max. for 3-5s



© W+P PRODUCTS



Series	Contacts*	Version	Colour*	Plating*	Package
5250	02 02-05	1 1 Stifte Male	30 30 Weiß (UL94 HB) White (UL94 HB) 20 Beige (UL94 V-0) Beige (UL94 V-0) 10 Schwarz (UL94 V-0) Black (UL94 V-0)	00 00 Au flash	TR TR Tape & Reel



Series	Contacts*	Version	Colour*	Sleeve Plating*	Clip Plating*	Package
5250	02 02-05	2 2 Buchsen Female	30 30 Weiß (UL94 HB) White (UL94 HB) 20 Beige (UL94 V-0) Beige (UL94 V-0) 10 Schwarz (UL94 V-0) Black (UL94 V-0)	00 00 Au flash 50 Sn	00 00 Au flash	TR TR Tape & Reel

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

